



UNDERFILL (Специальное вещество (герметик) позволяющее компенсировать разницу в скорости при тепловом расширении)

Свойства:

- Высокая капиллярность при высокоскоростном дозировании
- Без запаха при нанесении и высыхании
- Поддается дополнительной обработке при 120°C
- Совместим для работы с безотмывными флюсами
- Сохраняет свойства при длительном хранении
- Не образует пустот
- Скорость дозирования может быть увеличена на 25-35% по сравнению с предыдущими.

Описание:

Underfill FF35 без запаха, с низким коэффициентом поверхностного натяжения, однокомпонентное вещество на основе эпоксидной смолы, наносится точечным дозированием при монтаже под чип компоненты и компоненты в корпусах CSP, BGA, uBGA. Underfill FF35 обладает высокой капиллярностью, что обеспечивает быстрое и полное растекание. Underfill FF35 обладает высокой надежностью и температурой отвердевания, низким коэффициентом теплового расширения, обеспечивает оптимальное заполнение, не оставляет пустот, пригоден для работы с безотмывными флюсами, обладает высокой адгезией. Высокая проникающая способность, высокая дисперсность, высокая капиллярность обеспечивают быстрое растекание вещества и отвердевание вещества. Поддается дополнительной обработке при 120°C (250°F). Вязкость Underfill FF35 остается постоянной на протяжении всего срока хранения. Пригоден для работы со всеми чип компонентами.

Применение:

- Температура отвердевания: 150°C(300°F)
- Дополнительная обработка 120°C-140°C (250°F-280°F).
- Underfill FF35 сохраняет свои свойства в течении 10 дней при температуре 22°C (70°F) и 30% относительной влажности.
- Для достижения наилучших результатов основание печатной платы необходимо нагреть до температуры 40°C-50°C (100°F-120°F). Можно нагреть насадку дозатора для уменьшения вязкости вещества и повышения скорости дозирования.
- Давление в системе в пределах от 1 до 2.75 кгс/см2(бар). Скорость дозирования составляет от 0.25-1.25 см/с (0.10-0.50 дюйм/с). К тому же диаметр иглы дозатора должен составлять 0.025 – 0.075мм. Эти условия необходимы для наилучшего использования Underfill FF35.
- Для нанесения под маленькие изделия с размеров 0.65 мм обычно используется одна сторона или один угол без нанесения по периметру или второй точки. Низкая вязкость обеспечивает хорошую смачиваемость изделия, что обеспечивает распространение вещества до противоположного края для маленьких компонентов.

Условия хранения

- Underfill FF35 сохраняет свои свойства в течение 1 года при 4⁰-8⁰С, и должен храниться в холодильнике. Продукт не подлежит замораживанию.
- Перед использованием Underfill FF35 необходимо выдержать при комнатной температуре около 8 часов для равномерного прогревания.

Тщательно очищайте наконечник дозатора после каждого применения. Не оставляйте клей в наконечнике на продолжительное время

Время отвердевания при 100°С (210° F)	Время отвердевания при 125°С (260° F)	Время отвердевания при 150°С (300° F)
8- 10 минут	4-5 минут	1-2 минуты

Физические свойства:

Внешний вид	Удельный вес	Содержание влаги	Максимальная летучесть	Вязкость при 25° С (77° F) при 5 об/мин	Капиллярное движение	TG Температурный градиент	Содержание ионов
Желтый	1.25 г	0.02%	<1%	800 CPS	5мм/мин*	55°С	<10ppm

Изделие	Температурный градиент(TG), °С	Кэфф. теплового расширения ,UM/(MoC), перед TG	Кэфф. теплового расширения,UM/(MoC) после TG
FF35	55	47	165

Правила безопасности:

- Использование вентиляции и средств персональной защиты.
- В соответствии с сопроводительной документацией, техническими данными и индивидуальной информацией.
- Не хранить возле опасных (легковоспламеняющихся и токсичных) материалов, хранить только в специальных емкостях.



Интернет-магазин: www.shop.pribor.ru

Сайт компании: www.pribor.ru

Все для производства электроники

г. Санкт-Петербург, В.О., 8-я линия, д.59, кор. 2

Тел/факс: (812) 334-55-66 (многоканальный)

Факс: (812) 329-94-25

E-mail: pribor@pribor.ru

г. Москва, Научный проезд, д.10, оф.105.

т.(495) 632-02-92

E-mail: moscow@pribor.ru

